

证券代码：600355

证券简称：精伦电子

公告编号：临 2024-019

精伦电子股份有限公司

关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的议案》。

一、基本情况

为满足公司全资子公司经营与发展的资金需求，公司全资子公司武汉普利商用机器有限公司拟向中国银行股份有限公司武汉江岸支行申请不超过人民币1000万元的银行贷款，同时以母公司精伦电子股份有限公司自有房地产（不动产权号：鄂（2021）武汉市东开不动产权第0131990号）作为抵押担保。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议通过。上述贷款具体金额、抵押比例、期限、利率等相关事项公司将根据实际经营情况，由董事会授权管理层签订相关合同，具体内容以最终签署合同为准。

二、审批决策程序

2024年4月18日，公司召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会批准。

三、对公司的影响

本次贷款是公司全资子公司正常生产经营和日常业务发展所需，不存在损害公司及股东利益的情形。申请贷款所需的上述抵押有助于顺利取得银行借款，降低公司的融资成本，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2024年4月20日